2017-6-28 11:02:12

1. 最小加工孔径：0.3mm=12mil
2. 最大孔径：6.3mm=248mil
3. 单边孔环（单边焊环）：0.15mm=6mil
4. 孔的外径=孔径+单边孔环x2
5. Via导电孔，pad焊盘，分贴片焊盘和插件焊盘
6. 孔径公差正负0.08mm
7. 开孔孔径要比实际元件尺寸大0.1mm，考虑电镀铜和喷锡要加0.15mm
8. Via不会做开孔补偿，via过孔盖油，不能焊接
9. Via/pad之间最小间隙0.152mm=6mil
10. 最小线宽6mil，线之间最小间隙0.152mm=6mil，线与pad间隙10mil
11. 阻焊桥（绿油桥）：要求pad之间间隙大于0.352mm=14mil
12. 阻焊层solder mask：线路开窗是先在布线层(top layer/bottom layer)上画线再在top solder/bottom solder上开窗
13. Paste层用于做钢网，做PCB时不考虑
14. 字符宽大于6mil，高大于32mil，宽高比为1:6
15. 外形层用keep out layer
16. 拼板最小尺寸8cmx8cm，最大15cmx15cm
17. 工艺边宽5mm